

**国泰君安证券股份有限公司**  
**关于锦州神工半导体股份有限公司**  
**2024 年度持续督导跟踪报告**

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件的规定与要求，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责神工股份上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度跟踪报告。本持续督导年度跟踪报告释义与公司 2024 年年度报告一致。

**一、持续督导工作情况**

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与神工股份签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，持续关注神工股份的生产经营、信息披露情况
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所报告并经上海证券交易所审核后予以披露	2024 年度，神工股份在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应当自发现或应当发现之日起五个交易日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024 年度，神工股份在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所作出的各项承诺	2024年度持续督导期间，神工股份董事、监事、高级管理人员无违法违规和违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促神工股份依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对神工股份的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，神工股份的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	神工股份已按照证券监管部门的相关要求建立了信息披露制度。经核查，神工股份向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应当及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应当及时向上海证券交易所报告	保荐机构对神工股份的信息披露文件进行了审阅，不存在应当及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或者纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024年度，神工股份及其主要股东、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应当及时向上海证券交易所报告	2024年度，神工股份及其主要股东不存在未履行承诺的情况
13	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应当及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应当及时向上海证券交易所报告	2024年度，经保荐机构核查，不存在应当及时向上海证券交易所报告的情况

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告： （一）涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024 年度，神工股份及相关主体未出现该等事项
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2024 年度，神工股份及其相关主体未出现该等情况

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

### （一）经营风险

#### 1、客户集中风险

大直径硅材料产品是公司收入的主要来源。单晶硅材料行业具有进入门槛高、细分行业市场参与者较少等典型特征。公司主要海外客户分布在日本、韩国等国家和地区，客户集中度较高，存在客户集中风险。如公司下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化并在未来减少对公司产品的采购，或出现主要客户流失的情形，公司经营业绩存在下滑的风险。

#### 2、供应商集中风险

公司生产用原材料主要为高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚和石墨件等，其中高纯度多晶硅和高纯度石英坩埚主要采购自位于海外的终端供应商，公司高纯度

多晶硅和高纯度石英坩埚的采购渠道较为单一，采购集中度较高。如果公司主要供应商交付能力下降，公司原材料供应的稳定性、及时性和价格均可能发生不利变化，从而对公司的生产经营产生不利影响。

### **3、原材料价格波动风险**

公司生产用主要原材料为高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚和石墨件等，原材料成本占公司主营业务成本的比重较高，主要原材料价格的变化直接影响公司的利润水平。如果未来原材料价格大幅度上涨，且公司主要产品销售价格不能同步上调，将对公司的盈利能力产生不利影响。

### **4、业务波动及下滑风险**

公司的大直径单晶硅材料主要向下游集成电路刻蚀用零部件制造商销售。此类制造商对公司产品进行精密机械加工形成硅零部件产品，最终销售给等离子刻蚀机制造商或直接向集成电路制造厂商销售。

部分规模较大的硅零部件生产商除具备机械加工能力外，仍自行保有一定规模的大直径单晶硅材料生产能力。在行业上升周期，主要客户对单晶硅材料的增量需求主要通过外购满足，而在行业下行周期，主要客户因具备一定的大直径单晶硅材料生产能力，外购单晶硅材料的规模可能下降。因此，公司作为行业内主要的大直径单晶硅材料生产企业，在行业下行周期中可能面临较高的业务波动风险。

同时，报告期内公司产品的海外市场主要为日本、韩国，一旦世界贸易摩擦程度加剧，将对行业及公司业务带来不利影响，使公司向上述国家客户的销售收入减少，进而导致公司大直径硅材料产品利润下滑。同时公司下游客户采购计划的调整相比行业景气度恢复具有一定的滞后性，且半导体行业属于周期性行业，行业整体需求受全球地缘政治冲突等影响仍存在不确定性。

公司硅零部件和半导体大尺寸硅片产品，面向半导体等离子刻蚀机设备厂商和集成电路制造商销售。考虑到半导体行业景气度通过影响存量芯片生产线的产能利用率以及芯片生产线的新增投资水平，最终影响等离子刻蚀机硅零部件产品和半导体大尺寸硅片市场需求，因此公司以上两种产品的销售前景与半导体行业

景气度相关，在行业下行周期中同样可能面临一定的业务波动风险。

## 5、市场开拓及竞争风险

公司大直径硅材料产品的现有客户主要为半导体材料行业企业；硅零部件产品下游客户为国内等离子刻蚀机制造厂商和国内集成电路制造厂商，前者如北方华创、中微公司，后者如长江存储等公司；半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片的目标客户群体为国内外集成电路制造商，主要包括台湾积体电路制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司等企业。因此，公司大直径硅材料产品既有客户与硅零部件产品、半导体大尺寸硅片产品的目标客户并不重叠，公司拓展下游客户存在一定难度和不确定性；同时半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片所在细分市场的市场集中度较高，新进入者面临的市场竞争较为激烈，存在市场竞争风险，可能拉长前期技术投入的回报期或使公司无法有效应对市场竞争，将会对公司未来经营业绩产生不利影响。

为加快 8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目实现效益，公司已采取及拟采取的措施包括：

### 1) 发挥技术及人才优势，加强募投项目人员支持

公司专注于生产技术门槛更高、市场容量更大的轻掺低缺陷抛光硅片，依靠在日本拥有 20-30 年轻掺低缺陷硅片生产经验的核心技术团队，持续深入 8 英寸无缺陷晶体的工艺开发，全面掌握了晶体内部缺陷的控制方法。同时，公司始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才，人才储备丰富。

为了保障研发项目工作的顺利开展，公司成立了专门的项目开发小组，保障在研项目的人员配置。项目开发小组的主要成员均具有多年的半导体行业技术开发、工艺研究和生产组织管理方面的经验，能够确保在研项目按计划实施。公司将持续通过内部培养和外部引进的方式完善技术团队、提高技术实力，为项目配备经验丰富的人员，利用技术及人才优势加强对项目的技术支持，从而加快项目的效益实现进程。

## 2) 与供应商加强沟通合作，提高产品研发测试效率

对于募投项目的实施过程所需的设备、原材料及相关服务等，公司实施严格的供应商准入制度，设有合格供应商名单，并对该名单中的合格供应商服务进行定期考核和评定。在具体项目执行时，通常会综合考虑供应商产品或服务的稳定性、成本结构以及时间周期等因素，持续与供应商保持沟通，以确保相关研发测试工作的顺利开展，提高产品研发过程中的测试效率。

## 3) 提前与关键客户沟通对接，加快产品验证过程

公司 8 英寸硅片产品的正片认证周期较长，一般需要 9-18 个月，但一旦相关认证工作完成，芯片制造厂商通常不会轻易更换供应商。公司在研发过程中即提前与客户进行沟通对接，工艺实验围绕重点客户的特殊硅片工艺要求推进，并充分借鉴现有产品研发和测试分析经验以缩短产品的认证周期。公司将继续加大力度推进主流集成电路制造厂商的评估认证工作，并积极开拓中国本土大尺寸硅片的利基市场需求，力争通过主流集成电路制造厂商的正片评估并取得相应订单。

## 6、毛利率下滑的风险

近年来下游市场需求和行业竞争格局不断变化，未来随着公司大直径硅材料和硅零部件销售规模的扩大以及新增固定资产折旧的计提，若公司不能持续推出具有市场竞争力的优质产品，并通过提高生产效率、技术创新、规模效应等方式降低生产成本，大直径硅材料和硅零部件业务的毛利率都可能面临下滑的风险。

公司已采取或拟采取的应对措施包括：

### 1) 积极开拓市场，加强客户开发与维护，持续拓展国外国内营销网络

公司持续挖掘市场深度，维护巩固现有客户的合作关系，公司产品的海外市场为日本、韩国等国家和地区。凭借先进的生产制造技术、高效的产品供应体系以及良好的综合管理能力，公司与客户建立了长期稳定的合作关系。目前公司已成功进入国际先进半导体材料产业链体系，在行业内拥有了一定的知名度。未来，公司将利用先发优势，凭借过往合作的良好关系和公司产品质量口碑，通过完善

客户管理、提升客户服务水平等方式增强客户粘性，持续提高和现有客户的合作紧密程度，争取现有客户的持续性业务机会，并努力扩大业务合作规模。

公司拓宽市场广度，积极开拓新客户。在巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系同时，公司尤其注重与国内半导体行业新兴设备厂商及终端集成电路客户的接触。未来，公司将继续以客户为中心，在原有营销体系的基础上，通过扩大和完善国内销售及售后服务网络建设，加强国内市场覆盖，抓住国内半导体行业发展的机遇，凭借优质的产品性能和服务能力，积极拓展和培育符合公司整体战略方向的具有市场影响力的国内客户，扩大国内市场销售的份额。

#### 2) 加大技术研发投入，优化产品结构，保持产品竞争力

公司以行业技术发展趋势及客户核心需求为导向，持续培养和引进高素质研发技术人才，加大研发投入，储备新技术、新工艺，加强研发体系和能力建设，使公司保持高效的持续创新能力。一方面，公司将持续强化现有核心产品的技术优势，保持现有产品的核心竞争力，并重点加强为客户提供定制化产品与解决方案的能力；另一方面，公司将加大对现有产品横向及纵向产品线的研发投入，致力于实现半导体级单晶硅材料、硅零部件、半导体大尺寸硅片领域核心技术的突破，持续增强公司的行业竞争力和市场地位。

#### 3) 加强供应链管理，降低采购成本

公司持续提升对原材料市场进行研究和分析能力，密切关注原材料行情信息，根据市场价格波动情况及预期未来走势，结合公司安全库存、未来订单和排产计划，合理调整主要原材料备货量，尽可能降低原材料的采购成本。同时，公司将不断加强供应商管理，在与供应商保持长期稳定的合作关系的同时，积极开拓新的优质供应商，提高公司采购议价能力，在保证原材料品质的前提下，通过供应商询价与比价方式选择最有利的采购价格，不断降低采购成本。

#### 4) 强化生产管理水平，提高生产效率

在材料成本方面，公司将继续优化生产工艺流程或提升生产线自动化水平等方式，以进一步降低生产过程的材料损耗、提升产品良率和产品一致性；在人工

成本方面，公司将通过优化生产安排、提升生产自动化水平等方式，强化公司生产现场管理水平，进一步提高一线生产效率，降低生产成本。

#### 5) 完善团队建设，提升管理效率

公司将不断完善各岗位权责，优化业务流程，引入先进管理工具辅助工作。塑造积极向上的企业文化，促进团队交流与协作。构建科学合理的薪酬绩效体系，拓宽晋升渠道，加强表彰奖励，充分激发员工潜能与工作积极性。

### (二) 财务风险

公司半导体大尺寸硅片业务前期资本投入较大，相关产品尚处在认证阶段，产品的销售价格无法覆盖单位成本，目前产能利用率低，资产折旧和停工损失等因素可能对公司财务状况产生不利影响。

随着公司销售收入的增长，公司的应收账款余额较上年末有大幅增加。受行业竞争的影响，若未来主要客户经营情况发生变动，公司可能面临应收账款无法收回的风险，将对公司财务状况产生不利影响。

受公司产品市场需求、下游消费者市场价格变动的不确定性、半导体材料市场竞争格局的加剧、价格变动和人工成本上升等因素的影响，公司部分产品的毛利率存在下降的风险，毛利率的下降可能对公司财务状况产生不利影响。

公司的记账本位币为人民币，公司存在以美元和日元结算的购销业务，美元和日元与公司的记账本位币之间的汇率变动导致公司存在一定的汇率风险。

### (三) 行业风险

半导体行业属于周期性行业，行业增速与科技发展、全球经济形势高度相关。此外，半导体行业的周期性还受技术升级、市场结构变化、应用领域升级、自身库存变化等因素的影响。近年来，半导体行业研发周期不断缩短，新技术、新工艺的不断应用导致半导体产品的生命周期不断缩短，对公司的技术优势产生影响。

中美贸易摩擦仍然存在，对半导体产业链生产端造成负面影响，加之全球地缘政治军事冲突爆发等因素持续保持全球通胀高水平，消费者信心受挫导致下游

终端需求萎缩，全球半导体行业目前整体上景气度尚未全面恢复。未来若中美贸易摩擦进一步升级、半导体产业景气度下滑加剧影响扩大，公司的生产运营可能受到影响。

#### **（四）宏观环境风险**

全球范围内主要等离子刻蚀机生产厂商和刻蚀用硅电极制造厂商位于日本、韩国和美国，公司大直径硅材料产品的海外市场主要面向上述国家。如未来相关国家在贸易政策、关税等方面对我国设置壁垒或汇率发生不利变化，且公司不能采取有效措施降低成本、提升产品竞争力，将导致公司产品失去竞争优势，从而对公司经营业绩产生不利影响。

#### **（五）其他重大风险**

##### **1、募集资金投资项目建设风险**

公司募集资金投资的集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目涉及项目的前期准备、土建及机电工程、设备采购、设备安装调试等环节。本次募集资金投资项目在实施过程中可能受到工程施工进度、工程管理、设备采购、设备调试及人员配置等因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性，募集资金投资项目存在不能按期竣工投产的风险。

##### **2、新增折旧摊销影响公司盈利能力风险**

根据公司募集资金使用计划，募集资金投资项目建成后，公司资产规模将增加，从而导致公司年折旧及摊销成本费用增加。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产和无形资产投资带来的折旧和摊销，将在一定程度上影响公司净利润和净资产收益率水平。

#### **四、重大违规事项**

2024 年度，公司不存在重大违规事项。

#### **五、主要财务指标的变动原因及合理性**

2024 年度，公司主要财务数据如下所示：

主要会计数据	2024 年度	2023 年度	增减变动幅度 (%)
营业收入 (元)	302,729,514.81	135,033,152.23	124.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 (元)	299,559,445.56	129,443,827.09	131.42
归属于上市公司股东的净利润 (元)	41,150,745.84	-69,109,826.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	38,343,442.86	-71,555,263.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额 (元)	172,929,764.60	82,209,545.12	110.35
主要会计数据	2024 年 12 月末	2023 年 12 月末	增减变动幅度 (%)
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,792,961,454.97	1,761,794,579.03	1.77
总资产 (元)	1,992,903,335.46	1,933,422,436.15	3.08

2024 年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2024 年	2023 年	增减变动幅度 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.24	-0.43	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.24	-0.43	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.23	-0.44	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	2.32	-4.31	增加 6.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.16	-4.47	增加 6.63 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	8.26	16.64	减少 8.38 个百分点

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

公司 2024 年营业收入同比增加 124.19%，主要系半导体行业周期回暖，公司订单增加所致；归属于上市公司股东的净利润同比增加，主要系营业收入增加所致；经营活动产生的现金流量净额同比增加 110.35%，主要系营业收入增加导致回款增加等因素所致；公司 2024 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比由负转正，主要系报告期内归属于上市公司股东

的净利润增加所致。

综上，公司 2024 年度主要财务数据及指标变动具备合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

经过多年积累，公司形成了较强的技术、质量、客户、销售服务、细分行业方面的领先优势，具体如下：

### （一）技术优势

自成立以来，公司一直专注于大直径硅材料及其应用产品的研发、生产与销售，突破并优化了多项关键技术，构建了一定的技术壁垒。公司凭借无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等多项业内领先的工艺或技术，在维持较高良率和参数一致性水平的基础上有效降低了单位生产成本。报告期内，公司研发的“CVD-SiC 晶粒控制技术”，能够制备出高抗氧化性能、高抗热疲劳性能的涂层制品，满足高端客户需求。

### （二）质量优势

目前公司已经建立符合国际标准的质量控制和品质保证体系，并严格按照 ISO9001 质量管理体系认证的相关标准，在产品的设计开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制，实施精益生产，使产品质量得到巩固和提升。另外，公司在通过艰苦的努力，规范和提高生产各个环节的标准化，通过了 IATF16949: 2016 汽车行业质量管理体系认证，为产品在汽车行业的应用开辟通道。

### （三）客户优势

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格，认证周期较长，认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力，公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑，并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂，例如美国泛林集团（Lam Research）和日本东电电子（Tokyo Electron Limited, TEL），并最终销售给三星和

台积电等国际知名集成电路制造厂商。

报告期内，公司配合中国国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，适用于 12 英寸等离子刻蚀机，能够满足刻蚀机设备原厂不断提升的技术升级要求。公司产品的应用，已经从研发机型扩展至成熟量产机型。

#### **（四）销售服务优势**

公司建立了覆盖海内外的系统销售服务体系，持续完善覆盖日本、韩国客户的服务网络，并建立了兼具广度和深度的国内销售网络，覆盖了国内主流刻蚀机原厂以及行业主流集成电路制造厂商，能够提供及时可靠的售前和售后服务。

公司成立了由管理层负责的专业销售团队。通过定期及不定期拜访客户，能够快速、准确地理解客户的个性化需求，并及时获取行业技术发展动态及市场信息。公司在客户需求的响应速度、产品供货速度、持续服务能力等方面均表现良好，形成了销售服务优势。

目前，公司拥有泉州、锦州两处硅零部件工厂，南北两处厂区的布局能够高效完成研发对接，快速响应下游国内等离子刻蚀机生产厂家以及集成电路制造厂商客户自主委托定制改进硅零部件的需求，更好地服务全国客户。

#### **（五）细分行业领先优势**

公司自成立以来一直专注于大直径硅材料及其应用产品的生产、研发及销售。凭借多年的积累和布局，公司在大直径硅材料领域继续保持领先地位，掌握了 22 英寸及以下尺寸晶体的所有技术工艺，能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大直径硅材料产品，在全球细分领域处于领先地位。

公司顺应了等离子刻蚀机技术升级所带来的新需求，突破了大直径硅材料领域的诸多技术障碍，长期的品质一致性和成本优势为公司赢得了国际市场份额，并使下游客户对公司产生依赖。

近年来，公司在 16 英寸以上大直径硅材料领域的产能扩张较快，已经确保公司产能大于下游厂商的自有大直径硅材料产能，具有技术和规模双重优势。由于公司下游直接客户硅电极产品的主要应用场景在于终端客户集成电路制造厂商的 12 英寸生产线，而 12 英寸晶圆制造越来越多地采用 16 英寸以上大直径硅

材料产品所制成的硅零部件，因此公司具备独特的竞争优势。在硅零部件领域，公司是国内极少数具备“从晶体生长到硅电极成品”完整制造能力的一体化厂商。公司硅零部件产品的上游原材料（大直径刻蚀用单晶硅材料）具备稳定性、一致性、便捷性及成本的优势。

综上所述，2024 年度，公司核心竞争力未发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

2024 年度公司研发费用为 2,500.79 万元，较上年同期增加 11.32%，主要系公司增加研发投入所致。2024 年度公司研发投入占营业收入的比例为 8.26%，较上年同期减少 8.38 个百分点，主要系公司营业收入增长所致。

### （二）研发成果

公司的研发投入，综合考虑新产品布局、已有产品质量改善和经济效益综合考量，基于下游客户端具体明确的评估认证要求来开展研发活动。

大直径硅材料业务，公司在在大直径多晶硅材料及其制成品生产技术方面不断取得进展，取得了更多试验数据。硅零部件业务，持续强化定制开发能力，进一步满足下游客户的需求。半导体大尺寸硅片业务，公司致力于实现技术难度较大、毛利率较高的轻掺低缺陷硅片细分产品研发。报告期内共取得核心技术 1 项，获得发明专利 2 个，实用新型专利 11 个。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）实际募集资金金额和资金到位时间

#### 1、2020 年首次公开发行股票

经中国证监会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕100 号）核准，公司采用战略配售、网上网下方式

发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股21.67元。截至2020年2月17日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金总额866,800,000.00元，扣除承销费、保荐费76,049,433.93元后的790,750,566.07元已于2020年2月17日分别存入公司在中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行0708004329200067771账户300,000,000.00元，存入锦州银行股份有限公司金凌支行410100692121518账户300,000,000.00元，存入在锦州农村商业银行股份有限公司营业部392212010160740453账户190,750,566.07元；减除审计费、律师费、信息披露等发行费用15,881,132.08元后，实际募集资金净额为人民币774,869,433.99元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第1-00010文号的验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 2、2023年向特定对象发行股票

公司于2023年9月6日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票10,305,736股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为29.11元，募集资金总额为人民币299,999,974.96元，扣除不含税的发行费用人民币3,943,396.22元后，实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。上述资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月15日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

#### 1、2020年首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	774,869,433.99
减：期初累计已使用募集资金的金额	727,194,660.23

项目	金额
减：本期已使用募集资金的金额	5,666,149.65
减：募集资金结余利息补充流动资金的金额	92,337,456.13
加：募集资金专项账户银行利息收入	50,328,832.02
募集资金专户余额	0.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
公司	中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200067771	已注销，零余额
公司	锦州银行股份有限公司金陵支行	410100692121518	
公司	锦州农村商业银行股份有限公司营业部	392212010160740453	
合计			

## 2、2023 年向特定对象发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	296,056,578.74
减：期初累计已使用募集资金的金额	25,828,343.68
减：本期已使用募集资金的金额	97,656,976.78
减：募集资金结余利息补充流动资金的金额	1,352.54
加：募集资金专项账户银行利息收入	3,339,393.39
募集资金专户余额	175,909,299.13
其中：募集资金专户余额	30,909,299.13
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	145,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
公司	招商银行锦州分行营业部	416900037710703	30,909,299.13

开户主体	开户银行	银行账号	余额
公司	中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	已注销，零余额
合计			<b>30,909,299.13</b>

2024 年度，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2024 年度，公司主要股东更多亮照明有限公司、矽康半导体科技（上海）有限公司、北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）持股情况如下：

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	期末持股比例	变动原因
更多亮照明有限公司	0	37,003,560	21.73%	不适用
矽康半导体科技（上海）有限公司	0	35,550,301	20.87%	不适用
北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）	0	7,641,705	4.49%	不适用

截至 2024 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	间接持股方式	期末间接持股比例	增减变动原因
潘连胜	董事长、核心技术人员；总经理（届满离任）	通过持有矽康 75%的股权间接持有公司股份	15.66%	-

姓名	职务	间接持股方式	期末间接持股比例	增减变动原因
袁欣	董事、总经理；副总经理、董事会秘书、财务总监（届满离任）	通过持有矽康 25%的股权、直接及间接持有晶励投资 99.58%的份额、旭捷投资 2.47%的份额间接持有公司股份	6.91%	-
庄坚毅	董事	通过直接及间接持有更多亮 100%的股权间接持有公司股份	21.73%	-
哲凯	监事会主席	通过持有旭捷投资 12.38%的份额间接持有公司股份	0.04%	-
刘晴	监事	通过持有旭捷投资 12.38%的份额间接持有公司股份	0.04%	-
方华	职工代表监事	通过持有旭捷投资 12.38%的份额间接持有公司股份	0.04%	-

2024 年度，公司主要股东、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结的情形，报告期内除上述北京航天科工军民融合科技成果转化创业投资基金（有限合伙）减持和公司监事通过旭捷投资减持外，无其他减持情形。

#### 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无。

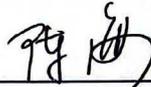
（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人签字：



姚巍巍



陈海



国泰君安证券股份有限公司

2025 年 3 月 26 日